

TSMCグループ唯一の半導体メーカー

Chiplet最新技術~2Dから3Dへ~ 講演

グローバル ユニチップ ジャパン Global Unichip Japan(株)



事業内容

顧客製品のエンジンとなるSoC (ASIC) 半導体設計開発&量産安定供給及び、SoCに搭載されるアナログ設計&販売も担う半導体メーカーです。

GUCの強み

TSMCの世界最先端プロセスを用いた世界初の顧客向け製品設計開発 (AI, スパコン, カメラ, 車載, スマホ, VR, SSD etc.)に携わることが可能。超有名な大手顧客に向けた未来の製品のエンジン設計開発に携わります。更に次世代SoCの最先端HBM & 3D設計技術 (Chiplet) も業界をリード。

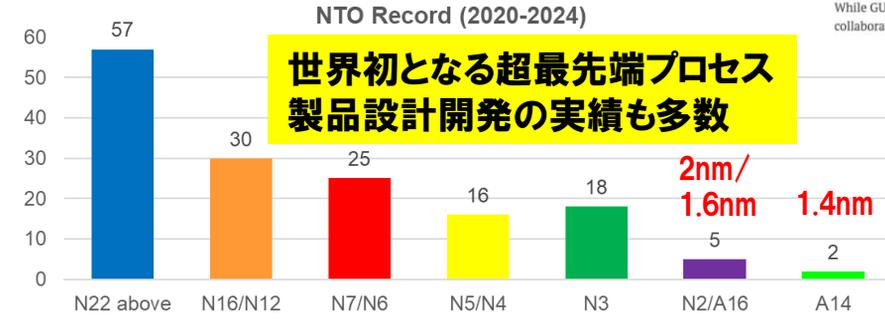


ChatGPT対応DRAM IF HBMは世界最速性能

GUC Announces Adoption of HBM3E IP by CSP Data Center

By Global Unichip Corp. 09.24.2024

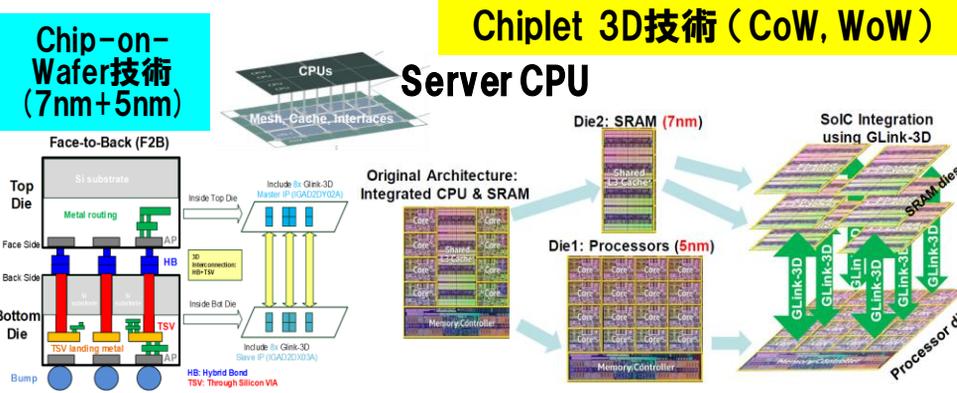
Hsinchu, Taiwan - September 24th, 2024 - Global Unichip Corp. (GUC), the Advanced ASIC Leader, is pleased to announce that its 3nm HBM3E Controller and PHY IP have been adopted by a leading Cloud Service Provider (CSP) and several High-Performance Computing (HPC) solution providers. This cutting-edge ASIC is expected to tape out this year and will feature the latest 9.2Gbps HBM3E memory technology.



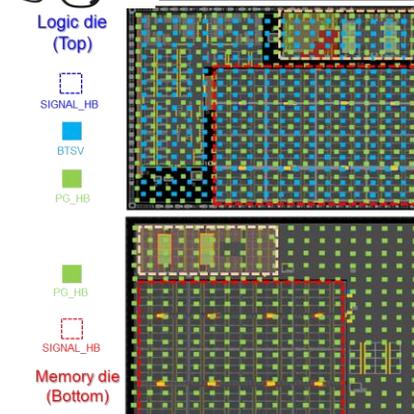
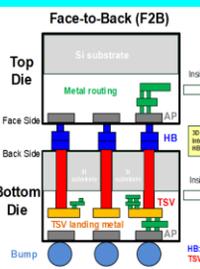
世界初となる超最先端プロセス 製品設計開発の実績も多数

Wafer-on-Wafer技術 (7nm+7nm)

AR Glasses



Chip-on-Wafer技術 (7nm+5nm)



講演内容 (IEEE Kansai woman in engineering主催)

1. 車載設計技術と今後の車載Chipletへ向けた世界のトレンド
2. Chiplet最新技術とPhysical実装技術 & 実機評価結果